



台積公司臨時董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2021年4月22日

台灣積體電路製造股份有限公司今（22）日召開臨時董事會，重要決議如下：

一、為吸引及留任公司高階主管，並將其獎酬連結股東利益與 ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行不超過普通股 2,600 仟股之 2021 年限制員工權利新股案，並將此案呈送 2021 年股東常會核准。

二、核准資本預算美金 28 億 8,700 萬元（約新台幣 793 億 9,250 萬元），以建置成熟製程產能。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2020 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 281 種製程技術，為 510 個客戶生產 1 萬 1,617 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com